



(19)

Generated Document

(11) Publication number:

02152673 A

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(21) Application number: 63295101

(51) Int. Cl.: B65D 73/02 B65D 85/38 H05K 13/02

(22) Application date: 22.11.88

(30) Priority:

(43) Date of application publication: 12.06.90

(84) Designated contracting states:

(71) Applicant: NEC CORP

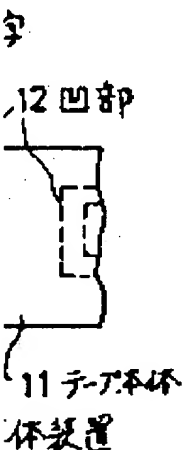
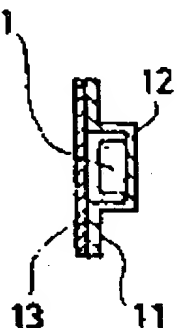
(72) Inventor: TAKATSUKI KUNIO

(74) Representative:

(54) PACKING TAPE OF SEMICONDUCTOR DEVICE

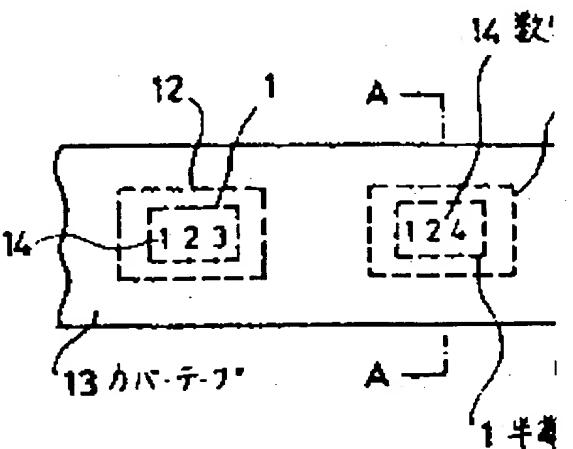
(57) Abstract:

PURPOSE: To easily confirm the number of packed semiconductor devices or the kind thereof by entering the numerals or marks corresponding to recessed parts in the cover tape bonded to a tape main body having recessed parts receiving semiconductor devices formed thereto to close the openings of the recessed parts.



CONSTITUTION: A plurality of recessed parts 12 are provided to a long tape main body 11 at an appropriate interval along the longitudinal direction thereof and semiconductor devices 1 can be received in the recessed parts 12 and a cover tape 13 is bonded to the tape main body 11 so as to close the openings of the recessed parts 12. The numerals 14 corresponding to the recessed parts 12 are entered in the cover tape 13. Herein, as the numerals 14, the arranging numbers of the recessed parts 12 are printed on the tape main body 11 from one end part thereof in order. Therefore, a series of numbers are applied to a packing tape corresponding to the respective recessed parts 12 and, by utilizing said numbers, the number of the semiconductor devices taken out from the tape or the remaining number of said devices can be simply confirmed and the control of the semiconductor devices can be easily performed.

COPYRIGHT: (C)1990,JPO&Japio



⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A) 平2-152673

⑬ Int. Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

⑭ 公開 平成2年(1990)6月12日

B 65 D 73/02
85/38
H 05 K 13/02

K 7818-3E
N 7405-3E

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全2頁)

⑮ 発明の名称 半導体装置の包装用テープ

⑯ 特 願 昭63-295101

⑰ 出 願 昭63(1988)11月22日

⑱ 発 明 者 高 月 邦 男 東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

⑲ 出 願 人 日本電気株式会社 東京都港区芝5丁目33番1号

⑳ 代 理 人 弁理士 鈴木 章夫

明 細 書

1. 発明の名称

半導体装置の包装用テープ

2. 特許請求の範囲

1. 半導体装置を収納する複数個の凹部を長さ方向に配列形成した長尺のテープ本体と、このテープ本体に貼着して前記凹部の開口を閉塞するカバーテープとを備え、このカバーテープには前記凹部に対応して数字や記号等を記載したことを特徴とする半導体装置の包装用テープ。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は半導体装置を一系列状態に1つずつ収納する包装用テープに関する。

(従来の技術)

従来、半導体装置の1つずつ収納する場合に、第3図に示す包装用テープが利用されている。第3図(a)は一部の正面図、同図(b)はそのB-B線に沿う断面図である。

即ち、長尺のテープ本体11に複数個の凹部12

を長さ方向に沿って形成し、この凹部12内に夫々半導体装置1を収納させる。また、凹部12を塞ぐように、テープ本体11にカバーテープ13を貼り付け、半導体装置1を包装している。

(発明が解決しようとする課題)

上述した従来の包装用テープは、一本のテープ本体11に数百個乃至数千個の凹部12を形成して半導体装置を包装しているため、この包装用テープから一部の半導体装置を取り出したときに、テープに包装されている半導体装置の数を直に知ることは困難である。また、テープを切断したような場合に、切断された包装用テープに包装された半導体装置の品種を区別することができなくなることがあるという問題もある。

本発明は上述した問題を解消することを可能とした包装用テープを提供することを目的とする。

(課題を解決するための手段)

本発明の半導体装置の包装用テープは、半導体装置を収納する複数個の凹部を長さ方向に配列形成した長尺のテープ本体と、このテープ本体に貼

特開平2-152673(2)

着して前記凹部の開口を開塞するカバーテープとで構成しており、かつカバーテープには前記凹部に対応して数字や記号等を記載している。

(作用)

上述した構成では、カバーテープに記載した数字や記号等を確認することで、包装している半導体装置の数や品種を容易に確認することが可能となる。

(実施例)

次に、本発明を図面を参照して説明する。

第1図は本発明の一実施例を示しており、同図(a)は一部の正面図、同図(b)はそのA-A線に沿う断面図である。図において、11は長尺のテープ本体であり、その長さ方向に沿って適宜間隔で複数個の凹部12を設けている。この凹部12内には半導体装置1を収納することができる。そして、この凹部12の開口を塞ぐように、前記テープ本体11にはカバーテープ13を貼り付けている。ここで、このカバーテープ13には、前記凹部12に対応して数字14を記載している。

この数字14は、ここでは凹部12の配列番号をテープ本体11の一端部から順番に印刷している。或いは、印刷する代わりにプリンタで刻印してもよい。

したがって、この包装用テープでは各凹部12に対応して一連の番号が付されることになるため、この番号を利用することで、テープから取り出した半導体装置1の数や残りの数を簡単に確認することができ、その管理を容易に行うことができる。

第2図は本発明の他の実施例の正面図であり、第1図と同一部分には同一符号を付して詳細な説明は省略する。ここでは、カバーテープ13には数字の代わりに半導体装置1の品種記号15を記載している。

この実施例では、品種記号15を見ることにより包装している半導体装置1の品種を直ちに確認することが可能となる。

(発明の効果)

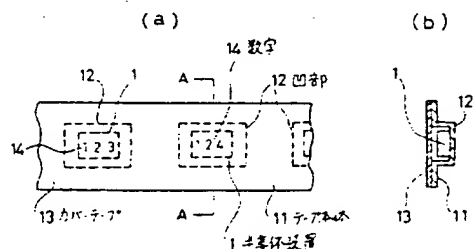
以上説明したように本発明は、半導体装置を収納する凹部を形成したテープ本体に貼着して凹部

の開口を開塞するカバーテープに、凹部に対応した数字や記号等を記載しているので、これらの数字や記号等を確認することで、包装している半導体装置の数や品種を容易に確認することができ、半導体装置の取り扱いを容易なものにできる効果がある。

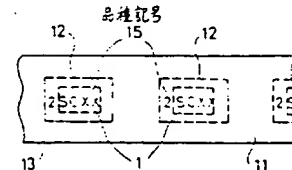
4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例を示し、同図(a)は一部の正面図、同図(b)はそのA-A線に沿う断面図、第2図は本発明の他の実施例の正面図、第3図は従来の包装用テープを示し、同図(a)は一部の正面図、同図(b)はそのB-B線に沿う断面図である。
1…半導体装置、11…テープ本体、12…凹部、13…カバーテープ、14…数字(番号)、15…品種記号。

第1図



第2図



第3図

